

風險因素

有意投資者於就本公司作出投資決定前應仔細考慮本文件所載的所有資料，尤其是須考慮下文所述的以下風險及不確定因素。下文所述的任何風險及不確定因素或會對我們的業務、財務狀況、經營業績，或股份交易價造成重大不利影響，且或會令閣下失去所有或部分投資。

有關我們業務及營運的風險

我們的營運可能因二手半導體製造設備耗材短缺而受到不利影響

我們為台灣二手半導體製造設備及零件的統包解決方案供應商及出口商。根據弗若斯特沙利文報告，就日本品牌下的二手半導體製造設備及零件而言，我們為台灣領先統包解決方案供應商及出口商之一。我們可能經歷二手半導體製造設備耗材供應短缺或延誤。由於我們的統包解決方案二手半導體製造設備是定制化，以整合至我們客戶的現有生產線，在若干情況下，我們可能需要採購二手半導體製造設備耗材的特定型號，以將其整改為與客戶現有生產線規格相同的半導體製造設備。於業績記錄期間，我們的二手半導體製造統包解決方案設備主要由日本一間領先生產商製造，而我們從世界各地的供應商處採購二手半導體製造設備。若我們未能以適當價格採購合適的二手半導體製造設備，我們不能向客戶提供適當的二手半導體製造統包解決方案，我們的客戶可能轉向其他二手半導體製造統包解決方案供應商或向半導體製造設備的原生產商採購全新半導體製造設備。

若半導體製造設備年代已經過時，生產商不再製造，該等老年代的二手半導體製造設備將在市場有限，同時，市場可能沒有足夠可用的新年代二手半導體製造設備。我們的業務取決於我們客戶對半導體製造設備年代更新的適應和應對程度。若我們在市場採購可用二手半導體製造設備遇到困難，我們的業務模式將受到重大不利影響。

我們依賴主要供應商提供二手半導體製造設備及零件的穩定供應

截至2016年12月31日止兩個年度，我們的五大供應商分別佔總採購約51.1%及56.7%，而來自最大供應商的採購分別佔總採購約32.8%及23.8%。我們並無與供應商訂立長期協議，我們根據接獲客戶的統包解決方案採購訂單採購二手半導體製造設備及零件。我們與供應商的未來關係及供應商向我們供應二手半導體製造設備及零件的意願將為我們的業務及營運的關鍵。倘我們的現有供應商不繼續向我們供應二手半導體製造設備及零件，我們的營運可能受到影響，而我們的財務狀況亦可能受到不利影響。

風險因素

由於客戶基於下游半導體產業的估計發展而調整產能，我們的收益可能在不同時期變化

由於我們為二手半導體製造設備統包解決方案供應商，我們相信對我們的解決方案的需求部分是受我們的客戶增加產能的意圖所推動。對於我們的客戶而言，他們主要使用我們的二手半導體製造設備生產用於下游半導體產業的半導體產品，例如手機、個人電腦、遊戲主機、DVD播放器及許多其他數字消費電子產品。因此，下游半導體產業需求改變將影響我們客戶的產能計劃，亦對我們的統包解決方案需求造成影響。

隨著下游半導體產業的快速發展，半導體生產商(即，我們的潛在客戶)的產能很可能是基於他們對下游半導體產品的估計。倘若下游半導體產業未按預計速度增長或該等估計嚴重偏離實際市場發展，半導體產品生產線可能出現產能過剩。這可能進而減弱我們的統包解決方案需求。因此，我們的財務狀況、經營業績及未來前景可能受到重大不利影響。

我們並無與我們任何客戶訂立長期銷售合約。來自我們客戶的購買模式受超出我們控制的多個因素影響，包括但不限於上述下游半導體產業的市場需求、我們客戶的目前產量及其生產擴張計劃。一般而言，由於其涉及資本密集投資，最大產量的調整不能進行及時及彈性的調整。因此，我們的收益及經營業績可能由於我們客戶的產能週期性調整而不時波動。

我們可能未能維持我們的過往毛利率

於業績記錄期間，我們已分別實現總毛利率約21.0%及19.2%。然而，我們於業績記錄期間實現的毛利率未能可作為估算我們未來毛利率的參考。我們維持過往毛利率的能力是根據競爭力、行業、宏觀經濟、材料成本及勞工成本波動、政府及監管因素及超出我們控制的狀況而定。

並不保證我們在開發業務的過程中成功克服所有挑戰及處理風險及不確定因素，亦不保證我們的毛利率能維持在業績記錄期間類似水平。倘若我們未能保持該等高毛利率，我們的財務業績可能受到不利影響。

我們的過往財務表現未必為我們未來的財務表現的指標，而我們已於截至2016年12月31日止年度較2015年同期經歷溢利下跌

截至2015年及2016年12月31日止年度，我們的收益分別為新台幣1,025.9百萬元及新台幣1,223.3百萬元(相當於增加約19.2%)，而我們於相應年度的純利由新台幣61.6百萬元減少至新台幣12.1百萬元。

風險因素

然而，有關本集團過往財務資料的趨勢僅為我們過去表現的分析，並不一定對我們未來的財務表現有任何正面影響且未必能反映我們未來的財務表現。我們未來的表現將取決於(其中包括)我們與現有客戶維持關係、自新客戶取得新業務、維持我們的服務質素及聲譽、控制成本、實施未來計劃及業務策略的能力，以及有關半導體行業、全球經濟的其他因素，而其他因素可能不受我們控制。因此，我們未來的財務表現未必達至市場分析員或投資者所預期，可能導致我們股份的未來價格下跌。

尤其是，我們於截至2016年12月31日止年度較2015年同期經歷溢利下跌。截至2015年及2016年12月31日止年度，我們的收益約為新台幣1,025.9百萬元及新台幣1,223.3百萬元(相當於增加約19.2%)。然而，我們於截至2015年12月31日止年度錄得溢利約新台幣61.6百萬元，並於截至2016年12月31日止年度錄得溢利約新台幣12.1百萬元。經扣除本集團的[編纂]後，我們於截至2016年12月31日止年度的溢利將約為新台幣51.1百萬元，倘我們無法維持利潤率，我們未來的財務表現未必達至市場分析員或投資者所預期，可能導致我們股份的未來價格下跌。

我們未必能夠維持來自與其他統包解決方案供應商買賣二手半導體製造設備及零件的正毛利率

於業績記錄期間，我們錄得來自向海外統包解決方案供應商銷售的毛(損)/利率分別約-4.9%及3.9%。本集團於定期評估我們手頭存貨時參與買賣我們自二手市場及/或半導體製造設備製造商客戶購入的二手半導體製造設備及零件。

本集團所出售二手半導體製造設備及零件的售價將取決於市場需求及參考二手市場價格。對於本集團認為市場需求較少的一些半導體製造設備型號，本集團將根據二手市場價格設定售價，一般接近本集團的收購成本。於業績記錄期間，本集團於考慮銷售成本(包括相關運輸成本)、存儲成本及匯兌虧損後，以接近收購成本之銷售價買賣若干型號的二手半導體製造設備，並錄得虧損或毛利率較低。

概不保證我們將能夠維持來自與其他統包解決方案供應商買賣二手半導體製造設備及零件的正毛利率。

我們的財務表現預期受有關[編纂]的非經常性開支的影響

我們董事估計[編纂]相關的總開支約為新台幣88.7百萬元，其中約新台幣3.0百萬元已計入我們截至2015年12月31日止年度綜合全面收益表，且約新台幣39.0百萬元已計入截至2016年12月31日止年度，約新台幣22.5百萬元預期計入我們截至2017年12月

風險因素

31日止年度的綜合全面收益表，以及約新台幣24.2百萬元預期歸屬於股份發行，並根據相關會計準則於成功[編纂]後從股本中扣除。[編纂]為非經常性的。我們董事預期本集團截至2017年12月31日止的財務表現將會受有關[編纂]開支的重大及不利影響。

新台幣兌美元及新台幣兌港元匯率波動可能會對我們的財務表現及閣下的投資造成重大不利影響

新台幣兌外幣(包括美元及港元)匯率受(其中包括)國際市場經濟環境變化的影響。本集團的銷售收據以新台幣及美元計值，採購則以美元計值。美元兌新台幣如出現任何不利變動，可能會導致本集團銷售成本增加或確認收益減少，因而導致的匯兌虧損及/或兌換虧損，並對本集團的經營業務及財務狀況造成不利影響。

就我們需要將[編纂]所得港元轉換成新台幣作營運用途來說，新台幣兌港元升值將對我們轉換所得的新台幣款額造成不利影響。相反，如果我們需要將新台幣轉換成港元用作就本公司股份派發股息或用作其他業務目的，則港元兌新台幣升值將會對本集團可得的港元款額造成負面影響。

目前，本集團並未訂立任何協議以對沖其匯率風險。如本集團未來訂立該等對沖，對沖的效力可能有限，且本集團未必能成功對沖其風險，或根本無法對沖風險。

我們於業績記錄期間維持一定水平的銀行借款，且於[編纂]後，我們或會繼續有大量銀行借款。借款成本受利率波動的影響，或會影響我們的業務、財務狀況、經營業績及前景

於業績記錄期間，我們維持一定水平的借款為我們的營運融資，且於[編纂]後，我們或會繼續有大量銀行存款。於2015年及2016年12月31日，我們的銀行借款分別約為新台幣392.3百萬元及新台幣473.1百萬元。截至2015年及2016年12月31日，我們的資產負債比率(按計息負債除以我們的總權益計算)分別約為155.1%及190.2%。

借款成本受利率波動的影響，且利率將會受到當時現行經濟狀況以及財務、業務和其他因素的影響，其中很多因素不受我們的控制，或會影響我們的營運。

儘管我們有內部控制措施，但我們的客戶延遲結算付款可能最終導致未來出現重大現金流量短缺及/或流動資金風險，可能對我們的現金狀況及經營業績造成不利影響

於2015年及2016年12月31日，我們的貿易應付款項周轉天數約為57.4天及52.6天。另外，於2015年及2016年12月31日，我們的貿易應收款項周轉天數約為76.6天及56.5天，高於貿易應付款項周轉天數。

風險因素

在我們提供統包解決方案的經營過程中，於確認客戶訂單後及收取客戶的合約金額或部分合約金額前，我們可能須知籌備統包解決方案期間提前支付若干成本及開支，或我們可能為維持統包解決方案的安全庫存而購買翻新二手半導體製造設備及零件。由於我們就原材料支付供應商的義務與我們訂立銷售合約未必為同一財政年度，我們可能因此在若干期間錄得來自經營活動的現金流出。我們的客戶一般須支付(i)於訂立合約後或於指定時段(一般為合約日期後一星期內)首付訂單價值20%至50%；(ii)於客戶初步檢測產品後及交付前初步驗收我們的產品時，支付產品交付付款訂單價值40%至60%；及(iii)於我們收到來自客戶的驗收證明後，支付產品驗收付款訂單價值10%至20%。收取來自客戶付款的任何延誤可能不利影響我們的現金流量狀況。

本集團或會面臨流動資金風險。並不保證我們將能消除風險及／或從客戶收取全部貿易應收款項。客戶付款任何違約或延誤或我們未能從他們收取貿易應收款項，可能導致未來即將作出貿易應收款項減值撥備。這種情況可能導致未來出現不合時宜及重大現金流量短缺及不利影響我們的現金狀況及經營業績。

如果對200毫米和300毫米硅片半導體製造設備的需求不能以我們預期的方式繼續發展，我們的業務可能會受到負面影響

我們專注於為200毫米及300毫米硅片二手半導體製造設備提供統包解決方案。我們的業務模式假設對200毫米及300毫米硅片的二手半導體製造設備的需求將繼續增長，在製造200毫米及300毫米硅片方面的專業用途將保持成本效益。然而，隨著製造450毫米硅片的成本隨著時間推移而改進，特別是折舊開支的下降，製造200毫米及300毫米硅片上的成本優勢在不久將來可能減少。由於成本優勢促進先進技術進步，客戶可能轉而製造450毫米硅片。

如果製造用於專業用途的半導體在未來顯著地轉向450毫米硅片，則對於200毫米和300毫米硅片二手半導體製造設備的需求將下降，我們的業務、經營業績及現金流量將受到不利影響。

我們可能未能維持在台灣的銷售及市場份額

根據弗若斯特沙利文報告，於2015年，我們貢獻收益新台幣8.8億元，佔台灣統包解決方案市場份額4.7%。此外，就日本品牌的二手半導體製造設備及零件而言，本集團被視為台灣領先統包解決方案供應商及出口商之一。我們的業務及經營增長取決於我們維持訂單數目、市場份額及提供統包解決方案方面的領先地位的能力。我們在中國及台灣的整體業務表現是根據競爭力、行業、宏觀經濟、政府及監管因素及超出我們控制的狀況而定。

風險因素

因此，我們不能向閣下保證，我們能夠維持在台灣的訂單數目、銷售及市場份額。任何對我們在台灣的銷售及市場份額有負面影響的因素可對我們的業務、經營業績及財務狀況產生重大不利影響。

為保持競爭力，我們必須跟上市場的需求變化及技術變化

我們投入財務及人力資源理解、開發及研究有關新一代半導體製造設備的新技術，以跟上客戶需求及市場需求。但是，並不保證這些方法有效，以及能滿足客戶，或我們能跟上二手半導體製造設備耗材的市場了解。倘若我們未能跟上不斷變化的需求及技術變化，滿足我們客戶的需求或我們的競爭對手開發超出本集團的技術，我們的業務、財務狀況及經營業績可能受到不利影響。

我們的研發活動未必能夠成功開發新產品

我們致力進行各種研發活動，以進一步發展我們的業務。該等活動及工作包括與台灣工業技術研究院合作以改進我們用於UVC-LED的MOCVD技術。有關我們研發的詳情，請參閱本文件「業務—原材料、供應商及採購—研發」一節。

我們無法保證我們開展的任何研發活動將於預期時限內完成，或有關研發活動的成本能夠完全或部分收回。我們無法向閣下保證，我們最終能夠商業化生產及推銷新產品。此外，倘我們的研發活動未能成功開發新產品，我們的聲譽、業務前景、財務狀況及經營業績可能會受到重大不利影響。

我們營運歷史有限，若我們未能克服挑戰，我們的業務可能受到重大不利影響

我們業務的營運歷史有限，而我們的業務開發僅從2009年開始。因此，我們繼續努力開發研究提供統二手半導體製造設備及零件包解決方案及擴展我們的服務組合以涵蓋不同半導體製造設備規格。

鑑於我們於2009年開始業務，我們用以評估前景的營運歷史有限。該等前景必須根據任何新公司一般面臨的風險、開支及困難而作出評估。這些風險包括本集團開發研究新技術的能力、我們維持及擴大市場份額的能力及成功與主要競爭對手競爭的能力，以及我們基於我們可用資源維持盈利能力的的能力。

並不保證本集團將成功克服挑戰，識別風險及不確定因素。若我們未能做到，我們的業務可能受到重大不利影響。

風險因素

我們大部份收益來自對主要客戶的銷售

於業績記錄期間，我們對客戶B(全球領先半導體製造商)的銷售分別為新台幣146.9百萬元及新台幣494.9百萬元，分別佔我們的總收益約14.3%及40.5%。我們對客戶A(全球領先半導體製造商)的銷售分別為新台幣503.2百萬元及新台幣325.6百萬元，分別佔我們的總收益約49.0%及26.6%。

我們並無與客戶B及客戶A訂立任何具購買責任的長期協議。客戶B及客戶A的購買通常按我們不時收取的購買訂單，當中並無承諾日後向我們下訂。客戶B及客戶A並無責任繼續與我們下購買訂單或按過往水平下購買訂單。因此，客戶B及客戶A可按意願取消、減少或遞延日後訂單或不再下訂。倘我們與客戶B及客戶A的關係轉差或終止，我們的業務及經營業績將受到不利影響。

倘我們未能審慎地管理我們的流動資金狀況，則我們拓展的能力以至經營業績會受到重大不利影響

概不保證我們的營運將產生足夠現金流入以提供我們所有業務活動所需資金及抵補我們的一般營運資金需求。倘我們無法從營運產生足夠現金以提供我們未來發展所需資金，則本集團的表現及前景以及我們執行業務計劃的能力將受到不利影響。有關本集團債項及流動資金、財務資源及資本架構的其他詳情，請參閱本文件「財務資料—本集團財務狀況及財務表現的討論及分析—流動資產淨額」一節。

我們高度依賴主要人員，流失這些主要人員可對我們的業務造成損害

我們的未來業務及經營業績在很大程度上取決於董事及高級管理層的持續貢獻。尤其是我們的執行董事楊名翔先生及范強生先生，自本集團成立以來一直帶領我們的高級管理層建立我們提供二手半導體製造設備及零件統包解決方案的市場地位。若失去他們任何一人的服務，可對本集團造成重大不利影響。董事及高級管理層成員是本集團的成功關鍵，因為他們對半導體製造設備行業擁有專業知識和經驗、對市場發展有見解，以及對本集團營運管理方面的技術發展和專業知識作出貢獻。此外，本集團管理層與客戶建立和維持的關係和聲譽，也是本集團賴以成功的因素之一。

我們預期董事、高級管理層團隊及我們的技術員工將繼續對本集團業務的未來增長和成功發揮重要作用。我們有效執行業務策略的能力將取決於(其中包括)成功招聘及挽留技術精湛和富經驗的管理人員及其他主要人員。並無保證我們將能夠聘用或挽留這些僱員，如果未能聘用或挽留任何這些人員，可對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。

風險因素

由於我們的二手半導體製造設備乃主要翻新自一個領導日本製造商品牌項下二手半導體製造設備，故我們可能有集中風險

我們出售的二手半導體製造設備主要翻新自一個領導日本製造商品牌項下二手設備。於業績記錄期間，我們的總收益逾89%乃來自該品牌的半導體製造設備。倘發生以下情況，有關集中情況可能對我們的營運施加不利影響：(i)我們大部份客戶以其他品牌設備取該品牌二手半導體製造設備，從而更改其生產線；(ii)該日本品牌項下二手半導體製造設備供應短缺；(iii)半導體製造行業出現重大動盪，導致該日本品牌的市場份額收縮及(iv)日本製造商的營運出現重大中斷。於有關情況下，本集團可能變得依賴該日本品牌，並可能未能與競爭對手在其他品牌競爭。

雖然根據日本品牌的年度報告，其營業收入有上升趨勢，根據弗若斯特沙利文報告，2015年日本品牌在全球半導體設備市場的市場份額約為11.7%，我們不能保證此日本品牌在市場上的普及程度將持續。有關我們集中於日本設備品牌的更多詳情，請參閱本文件「業務一對日本半導體製造設備品牌的依賴」一節。

我們面臨提供其他品牌統包解決方案的相關風險，此可能會影響我們的業務及盈利能力

雖然我們可切換到其他品牌的二手半導體製造設備統包解決方案，但我們的工程師需要費時熟悉其他品牌的設備規格。儘管本集團需要委聘熟悉其他品牌半導體製造設備技術的新工程師，概不保證我們可委聘充足熟悉其他品牌二手半導體製造設備技術的工程師。如果我們無法聘用足夠熟識其他品牌下二手半導體製造設備技術的工程師，我們的業務將受到不利影響。

本集團亦需要費時與其他品牌的二手半導體製造設備供應商建立關係。雖然我們的董事確認，我們的認可供應商名單上的供應商，包括我們的主要供應商、供應商F、供應商A及供應商B均能夠提供其他品牌的二手半導體製造設備，如果我們現有的供應商缺乏二手半導體製造設備的供應，本集團將需要時間與新供應商建立關係，概不保證我們可採購相關其他品牌的二手半導體製造設備。倘我們無法採購相關其他品牌的二手半導體製造設備，我們的營運將受到不利影響。

此外，我們的管理團隊需要費時建立在其他品牌下提供二手半導體製造設備統包解決方案的聲譽，而我們不能保證將有足夠對其他品牌二手半導體製造設備統包解決方案的需求。雖然本集團有提供日本品牌的二手半導體製造設備統包解決方案的聲譽，我們不能保證客戶會向我們下達其他品牌二手半導體製造設備統包解決方案的採購訂單，因為其他統包解決方案供應商已慣於提供其他品牌的二手半導體製造設備統包解決方案。如果我們無法獲得相關的採購訂單，我們的營運及盈利能力可能會受到不利影響。

風險因素

我們可能並無充足的保險保障

儘管我們已就營運投購保險，例如投購人壽保險，醫療保險，健康保險。我們的保險保障可能不足以保護本集團免受若干風險影響。因此，我們可能要從本身資源撥款，以就任何未投保的財務或其他損失、損害賠償及責任、訴訟或業務中斷付款。此外，某些事故(包括地震、火災、惡劣天氣、戰爭、水災、停電、恐怖襲擊或其他干擾事件)，以及這些事件造成的後果、損害及破壞，可能不受本集團保單的全面保障。如果我們的業務營運出現長時期中斷或干擾，我們可能招致成本及損失，因而可對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

與行業有關的風險

我們正面臨來自其他統包解決方案的競爭對手及一手設備生產商的競爭，這或會影響我們的業務及盈利能力

我們面對國內及國際半導體製造設備統包解決方案製造商的競爭。部份競爭對手可能相對我們有一定的優勢，包括更龐大的財務資源、更先進的技術、更大的規模經濟、更大的品牌認受性及在市場有更好的業務關係。日益激烈的競爭可能會導致價格和毛利率下跌，以及流失我們的市場份額，任何一項均可對我們的業務及盈利能力造成不利影響。有關我們的市場份額、競爭環境及主要競爭對手的資料，請參閱本文件「行業概覽—台灣半導體製造設備統包解決方案市場的競爭格局」一節。

儘管業務模式的不同，我們在向客戶提供半導體製造設備方面亦面臨來自一手設備生產商的競爭。儘管一手設備更為昂貴，因而我們認為其無法直接與我們的統包解決方案相比較，但在功能方面，一手設備可取代我們的統包解決方案。一手設備生產商可能向客戶提供更為先進的設備以及全面生產線解決方案，我們無法提供同類方案。同時，一手設備生產商將不會受市場二手設備短缺的風險所影響。若我們的客戶轉移其採購重點至一手設備生產商，我們的業務及盈利能力將受到不利影響。

台灣政府的行業政策改變可能不利影響我們的業務營運

自實施經濟改革以來，台灣對半導體行業發展的政策一直有利及鼓勵投資。此外，台灣政府亦鼓勵改進台灣半導體行業的技術，透過引入相關鼓勵政策。這導致半導體產品需求增加，而半導體產品正是我們的統包解決方案的終端產品。因此，我們的二手半導體製造設備統包解決方案需求自成立以來一直在增長。倘若台灣對半導體行業的開發及鼓勵政策有任何重大變化，我們的業務營運可能受到不利影響。

風險因素

台灣是我們的資產、營運和主要供應商及客戶的所在地，我們承受台灣的經濟、政治及監管狀況及風險

我們於業績記錄期間的所有收入幾乎都是源自我們在台灣的營運，而且絕大部份的資產均位於台灣。我們預料台灣在可見將來仍然是我們的主要市場。因此，我們的業務營運及前景受限於有關在台灣經營業務的若干風險，以及將會在較大程度上受中國的經濟、政治及法律發展影響。倘若台灣的本地生產總值及／或消費者開支增長有任何不利變動，則我們的經營業績、財務狀況及增長前景可能會受到重大不利影響。

台灣經濟在多方面有別於大部份已發展國家的經濟，包括結構、政府參與的程度、發展水平、資本投資的控制、增長率、資源分配、通脹率和貿易平衡狀況。我們無法預測台灣政治、經濟和社會狀況的轉變或台灣政府所頒佈法律、法規和政策的改變，是否將會對我們目前或日後的業務、財務狀況和經營業績有任何不利影響。

派息須受台灣法律限制

根據台灣法律，股息只能從可分派溢利中提取支付。我們的可分派溢利是根據台灣一般公認會計準則計算的純利，減去任何累計虧損收回金額及我們須作出的法定及其他儲備金撥款。因此，我們於未來(包括本集團財務報表顯示業務並無錄得溢利的期間)可能並無足夠或任何可分派溢利以向我們的股東作出股息分派。在某一年度未分派的任何可分派溢利均保留至以後年度作分派之用。

若因不遵守台灣工作場所安全法規而導致處罰或罰款，可能會對我們的聲譽及業務營運造成不利影響

我們的營運須遵守適用的工作場所健康及安全、消防安全、消防法律及其他法規。這些法律及法規日趨嚴厲。因此，我們或需要分配更多資源或資本開支以確保符合有關法律及法規。如果不遵守這些法律及法規，我們可能要採取糾正措施，及／或支付懲罰性費用或罰款。任何上述因素均可對我們的業務營運及業績造成重大不利影響。

與[編纂]有關的風險

可能不會形成交投活躍的股份交易市場

於[編纂]前，股份並無公開市場。股份獲准在創業板[編纂]，不保證股份在[編纂]後有交投活躍的市場，或股份將一直在創業板[編纂]及買賣。本集團無法保證[編纂]完成後將出現或維持交投活躍的市場，或股份市價不會跌破[編纂]。

風險因素

股份過往並無公開市場，且股份的流通量、市價及成交量可能波動

[編纂]後，股份的成交量及市價可能不時受多項因素影響，包括但不限於本集團的收益、盈利及現金流量、戰略聯盟及／或收購、本集團的服務市價波動或類似公司市價的波動、本集團高級管理層的變更及整體經濟狀況。任何有關事態發展均可能導致股份交易量及價格大幅及突然變化。概無法保證，該等事態發展是否會發生，亦難以量化對本集團及股份成交量及市價的影響。此外，在創業板上市的其他公司股份在過去均曾經歷大幅價格波動。股份價格可能不時出現未必直接與本集團財務或業務表現有關的波動。

股東股權可能被額外股本募集資金所攤薄

日後可能需要額外資金以為本集團業務及營運的擴張或新發展或新收購提供資金。倘透過不按比例向現有股東發行本公司的新股本或股本相關證券的方式籌集額外資金，則股東於本公司的擁有權百分比可能被攤薄或該等新證券可能賦予優先於[編纂]所提供的權利及特權。

倘現有股東日後於公開市場大量出售股份，可能會對股份的現行市價造成重大不利影響

我們的控股股東持有的股份受由股份開始於創業板買賣日期起的禁售期所限。並不保證控股股東將不會於禁售期後出售其所持有的股份。本集團不能預測任何主要股東或控股股東日後出售任何股份或任何主要股東或控股股東提供出售的股份對股份市價可能造成的影響(如有)。本公司任何主要股東或控股股東大量出售股份或本公司大量發行新股份，或市場認為有關出售或發行可能發生，均可對股份現行市價造成重大不利影響。

根據購股權計劃授出的任何購股權可能攤薄股東的股權

本公司已有條件採納購股權計劃。於最後實際可行日期，概無根據購股權計劃授出任何購股權以認購股份。於因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而發行新股份後，已發行股份的數目將會增加。因此，股東的持股量可能被攤薄或減少，導致每股盈利或每股資產淨值被攤薄或被降低。此外，根據購股權計劃將授予合資格參與者

風險因素

的購股權的公平值，將於購股權的歸屬期內計入本集團綜合全面收益表。購股權的公平值須於授出購股權當日釐定。因此，本集團的財務業績及盈利能力或會受到不利影響。

控股股東的利益可能並非經常與本集團的利益及其他股東的利益保持一致

控股股東對本集團的經營及業務策略有重大影響，及有能力透過彼等於本公司的股權要求本集團按照彼等自身意願來影響企業行動。我們控股股東的利益可能並非一直與其他股東的利益保持一致。倘控股股東的利益與其他股東的利益相衝突，或倘任何控股股東選擇致使本集團業務採取的策略目標與其他股東的利益有衝突，則本集團或有關其他股東的利益可能因此受到不利影響。

與本文件內陳述有關的風險

統計數字及行業資料可能有多個來源，未必可靠

本文件中「行業概覽」一節及其他部分有關半導體製造設備行業的若干事實、統計數字及數據部分來自政府官方或獨立第三方所編製的不同刊物及行業相關資料來源。本集團相信該等資料來源乃取自有關資料的合適來源。我們無理由相信有關資料乃錯誤或產生誤導，或遺漏任何事實以致有關資料錯誤或產生誤導。本集團、董事、保薦人、**[編纂]**、**[編纂]**、**[編纂]**及參與**[編纂]**的任何其他各方並無對該等資料及統計數字進行任何獨立審查，亦概無就該等資料及統計數字的準確性發表聲明。因此，該等統計數字及數據不應過份依賴。

本文件所載的前瞻性陳述可能被證實為不準確，因此投資者不應過度倚賴該等資料

本文件載有若干關於我們董事及本集團的計劃、目標、預期及意向的前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃依據本集團目前及未來的業務策略，以及本集團的經營環境發展的多項假設而作出。該等陳述涉及已知及未知風險、不確定因素及其他因素，可能導致本集團的實際財務業績、表現或成就大大有別於該等陳述所表達或暗示的本集團的預期財務業績、表現或成就。本集團的實際財務業績、表現或成就可能大大有別於本文件內所論述者。